

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 22 年 5 月 13 日 (2010.5.13)

【公開番号】特開 2009-164632 (P2009-164632A)
 【公開日】平成 21 年 7 月 23 日 (2009.7.23)
 【年通号数】公開・登録公報 2009-029
 【出願番号】特願 2009-97640 (P2009-97640)
 【国際特許分類】

H 0 5 K 1/14 (2006.01)

H 0 2 G 3/16 (2006.01)

【F I】

H 0 5 K 1/14 H

H 0 2 G 3/16 A

H 0 5 K 1/14 G

【手続補正書】
 【提出日】平成 22 年 3 月 29 日 (2010.3.29)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】特許請求の範囲
 【補正対象項目名】全文
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項 1】

三次元的に成型した合成樹脂材から成る樹脂プレート上に金属箔から成る回路パターンを載置した複数枚の回路基板を積層し、これらの回路基板の所定個所に前記積層した回路基板に共通の端子挿通孔を形成し、前記任意の層の回路基板の前記端子挿通孔に金属製の略円筒状の受端子を取り付け、該受端子に付設したタブを当該回路基板の前記回路パターンに接続し、前記共通の端子挿通孔にピン状の挿入端を有する挿入端子を挿通し、前記受端子を介して該当の前記回路基板の各層の前記回路パターンを電氣的に導通すると共に、突出した前記挿入端子により内在又は隣接する電子回路ユニットと接続することを特徴とする回路基板を用いたジョイントボックス。

【請求項 2】

前記電子回路ユニットはボックスに収容したことを特徴とする請求項 1 に記載のジョイントボックス。

【請求項 3】

前記受端子のタブは前記回路パターンに溶着により接続した請求項 1 又は 2 に記載の回路基板を用いたジョイントボックス。

【請求項 4】

前記受端子は短円筒状に形成した筒状接続部の上部にフランジ部を形成し、該フランジ部の一部に前記タブを付設し、前記筒状接続部を前記フランジ部の境界部をテーパ状の案内部としたことを特徴とする請求項 1 ～ 3 の何れか 1 つの請求項に記載のジョイントボックス。

【請求項 5】

前記挿入端は断面角型としたことを特徴とする請求項 1 ～ 4 の何れか 1 つの請求項に記載の回路基板を用いたジョイントボックス。